

便携孔内镀铜测厚仪的多种测量方式

| | |
|------|------------------|
| 产品名称 | 便携孔内镀铜测厚仪的多种测量方式 |
| 公司名称 | 沈阳远大科技园有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 沈阳经济技术开发区开发大路27号 |
| 联系电话 | 25162004 |

产品详情

第一台带温度补偿功能的测量孔内镀铜厚度的测厚仪CMI511是手持的电池供电的测厚仪。这款测厚仪能于侵蚀工序前、后，测量孔内镀层厚度。独特的设计使CMI511测厚仪能够完全胜任对双层或多层电路板的测量，甚至可以穿透锡和锡/铅抗蚀层进行测量。

CMI500孔铜测厚仪主要特点

测试蚀刻前后的孔内镀铜厚度

CMI500孔铜测厚仪技术参数

ETP孔铜探头测试技术参数：

可测试最小孔直径：35 mils (899 μ m)

测量厚度范围：0.08 – 4.0 mils (1 – 102 μ m)

电涡流原理：遵守ASTM-E376-96标准的相关规定

准确度： ± 0.01 mil (0.25 μ m) < 1 mil (25 μ m)

精确度：1.2 mil (30 μ m) 时，达到1.0%（实验室情况下）

分辨率：0.01 mils (0.1 μ m)

CMI500孔铜测厚仪介绍

第一台带温度补偿功能的测量孔内镀铜厚度的测厚仪CMI511是手持的电池供电的测厚仪。它能于侵蚀工序前、后，测量孔内镀层厚度。独特的设计使CMI500能够完全胜任对双层或多层电路板的测量，甚至可以穿透锡和锡/铅抗蚀层进行测量。

CMI511独有的温度补偿特性使其适用于在电镀过程中进行厚度测量，从而降低废料、返工成本。

和我们的所有产品一样，CM511在售前和售后都能够得到牛津仪器的优质服务的保证。

产品信息：www.chem17.com/st104931/erlist_1359944.html

www.chem17.com/st104931/sale_1382065.html